

证券代码：688498

证券简称：源杰科技

公告编号：2026-056

陕西源杰半导体科技股份有限公司 关于公司投资建设光电通讯半导体芯片和器件研发 生产基地二期项目进展的自愿性披露公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、对外投资概述

根据陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划，为把握市场机遇，提升规模化生产能力并增强行业竞争力，公司于2026年2月9日、2026年3月2日分别召开第二届董事会第二十六次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司拟投资建设光电通讯半导体芯片和器件研发生产基地二期项目的议案》，同意公司投资建设光电通讯半导体芯片和器件研发生产基地二期项目（以下简称“本项目”）。本项目主要内容为新建光芯片生产线及生产厂房、配套设施，投资总额约为12.51亿元人民币（以实际投入为准）。

具体详见公司于2026年2月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于公司拟投资建设光电通讯半导体芯片和器件研发生产基地二期项目的公告》（公告编号：2026-002）。

二、本项目进展情况

截至目前，本项目的土建工程、部分洁净室及相关配套设施已完成建设，首批生产设备预计近期开始进厂，并后续进行设备调试，预计2026年底至2027年初开始形成产能。整体项目进展符合预期，本项目为公司后续产能释放和业务发展奠定良好基础。

三、本项目对上市公司的影响

本次投资项目的实施，旨在通过优化产能布局与生产工艺，提升公司在高端光芯片领域的综合供应能力。项目建成后，将有助于公司把握市场增长机遇，

满足客户在数据中心建设等领域持续提升的产品需求，增强订单交付的稳定性与响应速度。公司将加强资金管理，合理规划资金安排，分阶段推进项目实施，不会影响现有主营业务的正常开展，不会对公司的经营成果及财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、相关风险提示

公司后续将按规划推进项目建设，项目建设过程中可能受国家或地方有关政策调整、设备调试进度、产能爬坡周期等因素的影响，项目实施进度、竣工时间及达产进度存在一定的不确定性。

项目达产后，仍可能面临宏观经济波动、行业政策、市场环境变化等不确定因素带来的风险，因此投资事项效果能否达到预期存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 16 日